

证券代码：001270

证券简称：铖昌科技

浙江铖昌科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20240827

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与单位	百年人寿、百年保险资管、朱雀基金、湘财基金、新华资管、长江资管、金鹰基金、浙商证券、中信证券、兴业证券、富达基金、海南儋石私募。
上市公司接待人员姓名	总经理：王立平 副总经理、董事会秘书：赵小婷 证券事务代表：朱峻瑶
时间	2024年8月27日
地点	会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<p>一、问答环节</p> <p>1、公司研发投入占收入较高，如何有效布局？</p> <p>答：公司在研发投入的布局上主要分为两个方面，一方面结合客户对芯片产品的功能和性能等需求，依托积累的技术与经验，不断提升性能、保持产品的技术先进性及成本优势，为下游应用提供更全面的产品解决方案；另一方面公司重点把握市场发展趋势，在前瞻性技术应用领域进行布局，加强技术预研产品的开发，提升产品应用性能等，进一步提高产品的竞争力并为下游客户提升产品性能助力。</p>

近年来，公司一直不断加大研发投入，旨在自主创新及核心技术能力的提升，2024年上半年公司研发投入总额为3,641.59万元，较上年同期相比增加1,388.62万元。公司持续加大市场开发力度，利用公司的技术和服务优势，承担多领域新装备研发需求，为公司在各领域的可持续发展提供了有力保障。

2、公司在卫星通信领域业务情况如何及最新进展？

答：在卫星通信领域方面，公司具备先发优势及核心技术创新优势。公司领先进入了主要客户核心供应商名录，卫星通信相控阵 T/R 芯片产品自 2022 年起批量生产并持续交付中，成为公司营收组成部分之一。

公司在卫星通信领域保持着相关优势，与科研院所等企业合作关系紧密，持续进行卫星通信 T/R 芯片解决方案的迭代研制，重点研制高宽带、高集成度、轻量化、多功能化、多波束、低功耗 MMIC 系列产品，并同步迭代面向卫星通信相控阵终端应用芯片解决方案，为进一步扩大市场份额做好相关储备。

3、公司 2024 年第一季度毛利率波动较大，目前已逐步回升，请介绍相关情况？

答：下游行业需求计划、价格体系的波动对公司毛利率产生了一定的影响，但目前下游用户需求已处于恢复状态，价格体系也在逐步趋于稳定。2024 年第一季度的毛利率波动较大，除受到营业收入规模较小、管理费用及研发投入增加等因素，项目以小批量交付为主，因此成本较高。第二季度项目情况已陆续恢复中并加快进入批量阶段。同时公司积极采取降本增效措施，公司紧跟市场需求和国内政策指引，进一步提高研发效率、提升公司产能及生产效率、积极推动精益化生产测试，并在员工管理方面做相关

管控。通过系列措施，可以看明显成效，2024年第二季度公司毛利率为60.83%，较2024年第一季度已大幅回升。

4、请介绍公司的产品生产流程？

答：公司产品生产流程主要包括晶圆流片、电性能测试、外观检验、划片、可靠性验证等多项环节，其中晶圆的流片、划片主要采用代工的模式完成，即公司将自主研发设计的集成电路版图交由晶圆流片厂进行晶圆流片，经公司测试后，再由划片厂进行划片。为保证产品质量，公司制定了一系列生产管理制度，公司对每一批出库的产品都执行测试、目检、复检，确保产品质量符合公司产品质量体系要求。

5、随着终端装备小型化轻量化趋势发展，SIP模组工艺会对公司产品产生影响吗？

答：SIP封装是将多种功能芯片，根据用户的应用场景和使用要求，集成在一个封装内，从而实现一个基本完整的功能，属于公司下游用户的一种封装方案。公司产品相控阵T/R芯片作为SIP模组内的核心器件之一，具有重要作用。

6、公司第三代半导体氮化镓工艺的系列化产品已批产，请介绍相关优势？

答：氮化镓工艺凭借其独特的优势，在高温大功率器件和高频微波器件应用方面有着广阔的前景。公司产品第三代半导体氮化镓功率放大器芯片具有体积小、宽禁带、耐高压、耐高温、高功率密度等多方面优势，可满足高功率相控阵雷达的应用场景，自2022年起已规模应用于地面领域。

另外针对毫米波应用，公司联合下游厂商持续进行先进节点氮化镓工艺优化及产品迭代开发，重点提升产品功

	<p>率密度、附加效率和可靠性能。</p> <p>7、请问数字相控阵雷达的应用是否会对公司产品产生影响？</p> <p>答：目前装备列装相控阵雷达以模拟相控阵为主，同时数字相控阵雷达也需使用相控阵 T/R 芯片，公司产品亦可应用于数字相控阵雷达中。</p> <p>8、请问公司项目流程及周期一般是多久？</p> <p>答：在前期研发过程中，公司内部对项目评审通过后进行立项并出具技术方案，待各项指标性能符合客户需求后，与客户进行技术评审和项目商务谈判。</p> <p>公司积极拓展产品应用领域，目前在手研发项目涵盖星载、地面、机载、舰载等领域，各项目因应用场景、体量、难易度等不同，周期存在一定差异。</p> <p>9、在报告中看到公司在机载领域有所突破，进展情况如何？</p> <p>答：公司一直积极开拓应用领域，前期布局了机载领域的多个项目。自今年起机载领域芯片产品已在多个型号装备中陆续进入量产阶段，产品主要以机载通信应用的相控阵天线 T/R 芯片为主，并有着持续量产需求，已成为公司营收中新的增长点。目前公司已在积极备货积极生产交付中。</p> <p>公司与下游客户形成深度的合作配套关系，将有效的推进项目进度。公司将继续拓展下游应用领域，扩大产品在多领域的市场份额。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使</p>	<p>无</p>

用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	
---------------------------	--